

无锡泰连芯科技有限公司

TLX633X 型

1. 1MHz、轨至轨I/O CMOS运算放大器

2024年06月

1.1MHz、轨至轨 I/O CMOS 运算放大器

1 特点

- 高增益带宽: **1.1 MHz**
- 轨到轨输入和输出
 $\pm 0.6mV$ 典型值
- 输入电压范围: **-0.1V 至 +5.6V**
- **V_s = 5.5V**
- 电源范围: **+ 2.2V 至 +5.5V**
- 额定温度高达 **+125°C**
- 微型封装: **SOT23-5、SOP8、MSOP8、TSSOP8、SOP14、TSSOP14、QFN3X3-16**

2 应用

- 传感器
- 光电二极管放大
- 有源滤波器
- 测试设备
- 驱动 A/D 转换器

3 描述

TLX6331、TLX6332、TLX6334 系列产品提供低电压运行和轨到轨输入输出，以及卓越的速度/功耗比，可提供出色的带宽 (**1.1MHz**) 和 **0.5V/ μs** 的压摆率。这些运算放大器具有单位增益稳定和超低输入偏置电流。

这些器件非常适合传感器接口、有源滤波器和便携式应用。**TLX6331、TLX6332、TLX6334** 系列运算放大器可在**2.2V** 至 **5.5V** 单电源或双电源供电下工作于**-55 °C**至**125 °C**的全温度范围内。

质量等级: 军温级**&N1**级

设备信息⁽¹⁾

产品编号	封装	主体尺寸 (标称)
TLX6331	SOT23-5	2.90mm×1.60mm
TLX6332	SOP8	4.90mm×3.90mm
	MSOP8	3.00mm×3.00mm
	TSSOP8	3.00mm×4.40mm
TLX6334	SOP14	8.65mm×3.90mm
	TSSOP14	5.00mm×4.40mm
	QFN3X3-16	3.00mm×3.00mm

(1) 对于所有可用的封装，请参阅数据表末尾的可订购附录。

目录

1 特点	2
2 应用	2
3 描述	2
4 修订历史	4
5 封装/订购信息 ⁽¹⁾	5
6 引脚配置和功能	6
7 规格	9
7.1 绝对最大额定值	9
7.2 ESD 评级	9
7.3 推荐工作条件	9
7.4 电气特性	10
7.5 典型特性	12
8 应用与实施	15
8.1 应用说明	15
8.2 布局指南	15
8.3 仪表放大器	15
9 封装外形尺寸	16
10 卷带信息	23

4 修订历史

注意：以前修订的页码可能与当前版本的页码不同。

版本	变更日期	更改项目
C.2	2021/06/09	更新 RevC.1 第 2 页的封装数量
C.3	2023/07/28	1. 添加卷带信息 2. 删除 TLX6331XK / TLX6331XM / TLX6331SXK 可订购设备
C.3.1	2024/03/05	修改包装命名
C.4	2024/12/18	在 RevC.3.1 第 4 页添加 MSL 2. 删除 TLX6332XTDC8 / TLX6332XTDE8 / TLX6331SXH / TLX6332SXN 可订购设备 3. 删除与 TLX6331S 和 TLX6332S 相关的内容

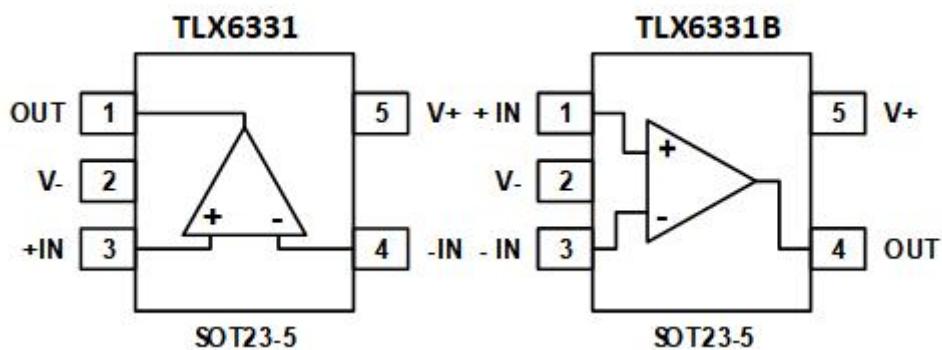
5 封装/订购信息⁽¹⁾

订购型号	温度等级	封装类型	丝印标记 ⁽²⁾	MSL	质量等级
JTLX6331XF	-55 °C ~+125 °C	SOT23-5	6331	MSL1/3	N1/军温级
JTLX6331BXF	-55 °C ~+125 °C	SOT23-5	6331B	MSL1/3	N1/军温级
JTLX6332XK	-55 °C ~+125 °C	SOP8	TLX6332	MSL1/3	N1/军温级
JTLX6332XM	-55 °C ~+125 °C	MSOP8	TLX6332	MSL1/3	N1/军温级
JTLX6332XQ	-55 °C ~+125 °C	TSSOP8	TLX6332	MSL1/3	N1/军温级
JTLX6334XP	-55 °C ~+125 °C	SOP14	TLX6334	MSL1/3	N1/军温级
JTLX6334XQ	-55 °C ~+125 °C	TSSOP14	TLX6334	MSL1/3	N1/军温级
JTLX6334XTQC16	-55 °C ~+125 °C	QFN3X3-16	TLX6334	MSL1/3	N1/军温级
TLX6331XF	-40 °C ~+125 °C	SOT23-5	6331	MSL1/3	工业级
TLX6331BXF	-40 °C ~+125 °C	SOT23-5	6331B	MSL1/3	工业级
TLX6332XK	-40 °C ~+125 °C	SOP8	TLX6332	MSL1/3	工业级
TLX6332XM	-40 °C ~+125 °C	MSOP8	TLX6332	MSL1/3	工业级
TLX6332XQ	-40 °C ~+125 °C	TSSOP8	TLX6332	MSL1/3	工业级
TLX6334XP	-40 °C ~+125 °C	SOP14	TLX6334	MSL1/3	工业级
TLX6334XQ	-40 °C ~+125 °C	TSSOP14	TLX6334	MSL1/3	工业级
TLX6334XTQC16	-40 °C ~+125 °C	QFN3X3-16	TLX6334	MSL1/3	工业级

笔记:

- (1) 此信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知，亦不会修订本文档。如需此数据表的浏览器版本，请参阅右侧导航栏。
- (2) 可能有额外的标记，涉及批次跟踪代码信息（数据代码和供应商代码）、设备上的徽标或环境类别。
- (3) TLXIC 在其组装工厂内使用符合 JEDEC 工业标准 J-STD-20F 的通用预处理设置来划分 MSL 等级。如果您的最终应用对预处理设置要求严格，或者您有特殊要求，请与 TLXIC 协商。

6 引脚配置和功能

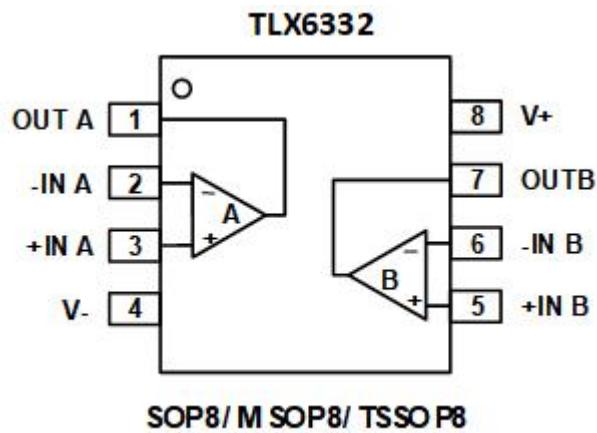


引脚描述

代码	引脚		I/O ⁽¹⁾	描述
	TLX6331	TLX6331B		
	SOT23-5	SOT23-5		
-IN	4	3	I	负（反相）输入
+IN	3	1	I	正（同相）输入
OUT	1	4	O	输出
V-	2	2	-	负（最低）电源
V+	5	5	-	正极（最高）电源

(1) I = 输入, O = 输出。

引脚配置和功能

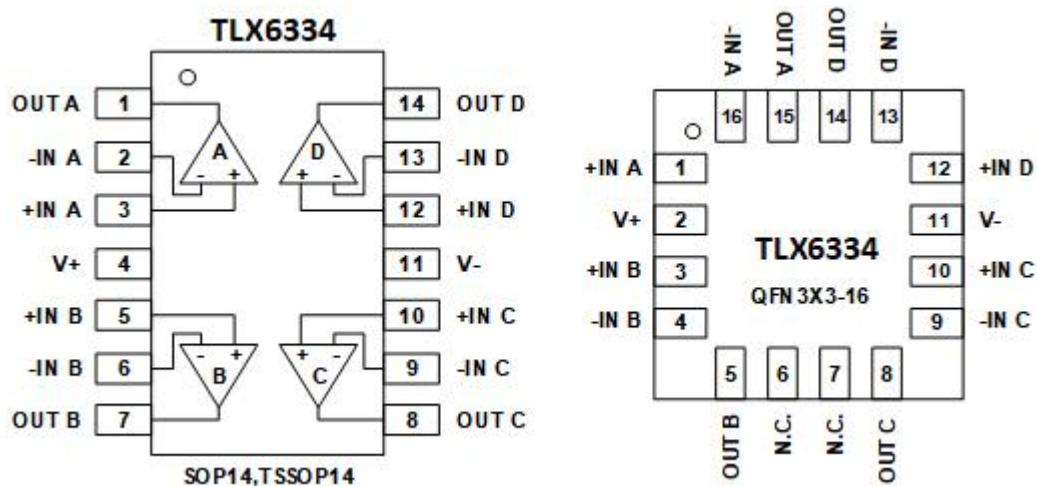


引脚描述

代码	引脚	I/O ⁽¹⁾	描述
	TLX6332		
	SOP8/MSOP8/TSSOP8		
-INA	2	I	反相输入, 通道A
+INA	3	I	同相输入, 通道A
-INB	6	I	反相输入, 通道B
+INB	5	I	同相输入, 通道B
OUTA	1	O	输出, 通道A
OUTB	7	O	输出, 通道B
V-	4	-	负(最低)电源
V+	8	-	正极(最高)电源

(1) I = 输入, O = 输出。

引脚配置和功能



引脚描述

代码	引脚		I/O ⁽¹⁾	描述
	SOP14/TSSOP14	QFN3X3-16		
-INA	2	16	I	反相输入, 通道A
+INA	3	1	I	同相输入, 通道A
-INB	6	4	I	反相输入, 通道B
+INB	5	3	I	同相输入, 通道B
-INC	9	9	I	反相输入, 通道C
+INC	10	10	I	同相输入, 通道C
-IND	13	13	I	反相输入, 通道D
+IND	12	12	I	同相输入, 通道D
OUTA	1	15	O	输出, 通道A
OUTB	7	5	O	输出, 通道B
OUTC	8	8	O	输出, 通道C
OUTD	14	14	O	输出, 通道D
V-	11	11	-	负(最低)电源
V+	4	2	-	正极(最高)电源
-	-	导热垫	-	将导热垫连接至V-

(1) I = 输入, O = 输出。

7 规格

7.1 绝对最大额定值

在自然通风工作温度范围内（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电压	电源, $V_s = (V+) - (V-)$		7	V
	信号输入引脚 ⁽²⁾	(V-) - 0.5	(V+) + 0.5	
	信号输出引脚 ⁽³⁾	(V-) - 0.5	(V+) + 0.5	
电流	信号输入引脚 ⁽²⁾	-10	10	mA
	信号输出引脚 ⁽³⁾	-100	100	mA
	输出短路 ⁽⁴⁾	连续的		
θ_{JA}	封装热阻 ⁽⁵⁾	SOT23-5	230	°C/W
		SOP8	110	
		MSOP8	170	
		TSSOP8	240	
		SOP14	105	
		TSSOP14	90	
		QFN3X3-16	70	
温度	工作范围, T_A	-55	125	°C
	交界处, $T_J^{(6)}$	-55	150	
	储存, T_{stg}	-65	150	

(1) 超过这些额定值的应力可能会造成永久性损坏。长时间暴露于绝对最大条件可能会降低器件的可靠性。这些仅为应力额定值，并不保证器件在这些或任何其他超出规定值的条件下能够正常工作。

(2) 输入端采用二极管钳位连接到电源轨。如果输入信号摆幅超过电源轨 **0.5V**，则应将电流限制在 **10mA** 或以下。

(3) 输出端采用二极管钳位连接到电源轨。输出信号摆幅超过电源轨 **0.5V** 以上时，应将电流限制在 **±100mA** 或以下。

(4) 短路至地，每个包装一个放大器。

(5) 封装热阻按照**JESD-51**计算。

(6) 最大功耗是 $T_{J(MAX)}$ 、 R_{JA} 和 T_A 的函数。任何环境温度下允许的最大功耗为 $P_D = (T_{J(MAX)} - T_A) / R_{JA}$ 。所有数值均适用于直接焊接在 **PCB** 上的封装。

7.2 ESD 评级

以下 **ESD** 信息仅适用于在 **ESD** 保护区内处理 **ESD** 敏感设备。

			数值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体模型 (HBM)	±5000	V
		机械模型 (MM)	±400	



ESD 敏感度警告

ESD 损害的范围很广，从轻微的性能下降到器件的彻底失效。精密集成电路更容易受到损坏，因为即使很小的参数变化也可能导致器件不符合其公开的规格。

7.3 推荐工作条件

在自然通风工作温度范围内（除非另有说明）

		最小值	正常值	最大值	单位
电源电压, $V_s = (V+) - (V-)$	单电源	2.2		5.5	V
	双电源	±1.1		±2.75	

7.4 电气特性

($T_A = +25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 时连接至 $V_{S/2}$, 且 $V_{OUT} = V_S/2$, $V_{CM} = V_S/2$, 满载⁽⁹⁾ = -55 °C至 +125 °C, 除非另有说明。)⁽¹⁾

范围		状况	T_J	TLX6331、TLX6332、TLX6334			
				最小 ⁽²⁾	典型 ⁽³⁾	最大 ⁽²⁾	单位
电源							
V_S	工作电压范围		25°C	2.2		5.5	V
I_Q	每个放大器的静态电流		25°C		58	80	μA
$PSRR$	电源抑制率	$V_S = 2.2\text{V to } 5.5\text{V}$, $V_{CM} = (V-) + 0.5\text{V}$	25°C	72	90		dB
			Full	65			
输入							
V_{OS}	输入失调电压	$V_{CM} = V_S/2$	25°C	-3	± 0.6	3	mV
$V_{OS T_c}$	输入失调电压平均漂移	$V_{CM} = V_S/2$	Full		± 2		$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
I_B	输入偏置电流 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾		25°C		± 1	± 10	pA
I_{OS}	输入失调电流 ⁽⁵⁾		25°C		± 1	± 10	pA
V_{CM}	共模电压范围	$V_S = 5.5\text{V}$	25°C	-0.1		5.6	V
$CMRR$	共模抑制比	$V_S = 5.5\text{V}$, $V_{CM} = -0.1\text{V to } 4\text{V}$	25°C	71	90		dB
			Full	68			
		$V_S = 5.5\text{V}$, $V_{CM} = -0.1\text{V to } 5.6\text{V}$	25°C	60	80		
输出							
A_{OL}	开环电压增益	$R_L = 2\text{k}\Omega$, $V_O = 0.15\text{V to } 4.85\text{V}$	25°C	94	105		dB
			Full	85			
		$R_L = 10\text{k}\Omega$, $V_O = 0.05\text{V to } 4.95\text{V}$	25°C	100	110		
	输出摆幅与轨距	$R_L = 2\text{k}\Omega$	25°C		25		mV
		$R_L = 10\text{k}\Omega$			8		
I_{OUT}	输出短路电流 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾		25°C		± 55		mA
频率响应							
SR	转换速率 ⁽⁸⁾		25°C		0.5		$\text{V}/\mu\text{s}$
GBP	增益带宽积		25°C		1.1		MHz
PM	相位裕度		25°C		64		$^\circ$
t_s	稳定时间, 0.1%		25°C		1.3		μs
	过载恢复时间	$V_{IN} \cdot \text{Gain} \geq V_S$	25°C		2.3		μs
噪音							
e_n	输入电压噪声密度	$f = 1\text{kHz}$	25°C		22		$\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
		$f = 10\text{kHz}$	25°C		20		$\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$

笔记:

- (1) 电气表值仅适用于所示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件下器件的自热效应非常有限。
- (2) 限值是在 **25°C** 下进行 **100%** 生产测试得出的。工作温度范围内的限值通过统计质量控制 (**SQC**) 方法的相关性来确保。
- (3) 典型值代表特性测定时确定的最可能的参数标准。实际典型值可能随时间变化，并取决于应用和配置。
- (4) 正电流对应于流入器件的电流。
- (5) 此参数由设计和/或特性确保，并未在生产中测试。
- (6) 最大功耗是 **T_{J(MAX)}**、**R_{θJA}** 和 **T_A** 的函数。任何环境温度下允许的最大功耗为 $P_D = (T_{J(MAX)} - T_A) / R_{\theta JA}$ 。所有数值均适用于直接焊接在 **PCB** 上的封装。
- (7) 短路试验是瞬时试验。
- (8) 指定的数字是正向或负向斜率中较慢的一个。
- (9) 仅通过特性指定。

7.5 典型特性

注意：本说明后面提供的图表是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 、 $V_s = 5\text{V}$ 、 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 时连接至 $V_{\text{OUT}} = V_s/2$ ，除非另有说明。

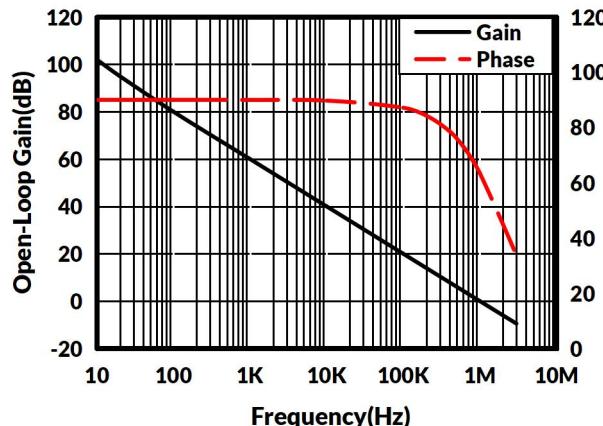


图 1. 开环增益和相位与频率的关系

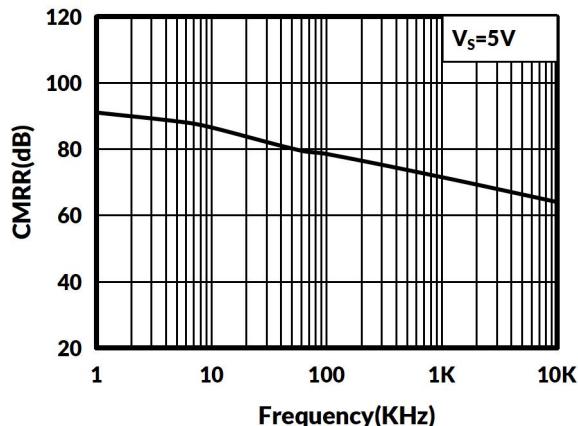


图 2. 共模抑制比与频率的关系

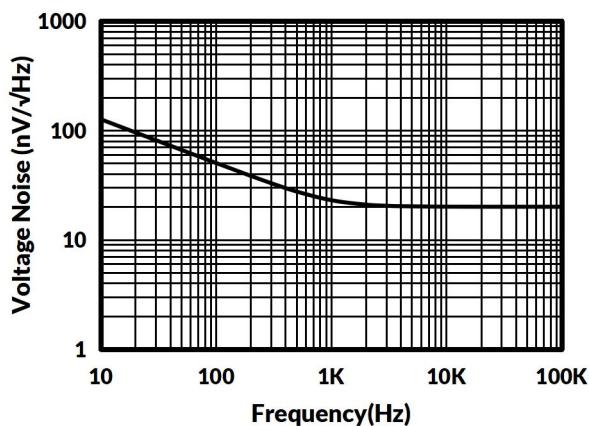


图 3. 输入电压噪声频谱密度与频率的关系

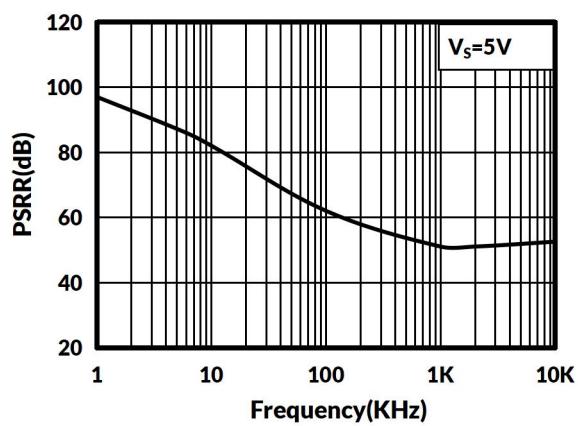


图 4. 电源抑制比与频率的关系

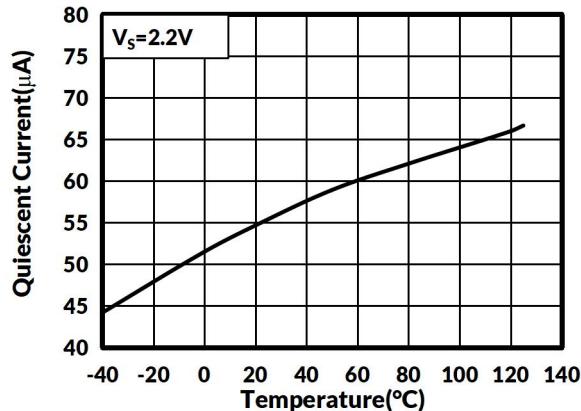


图 5. 静态电流与温度的关系

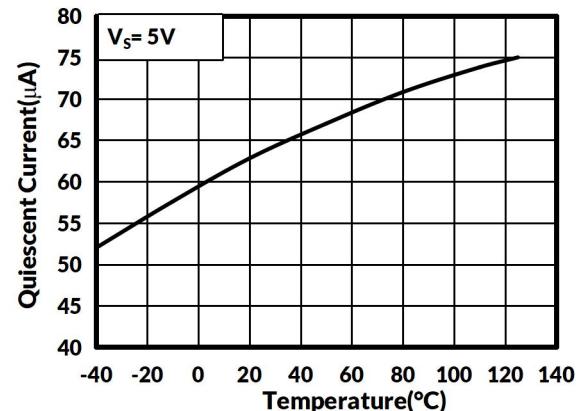


图 6. 静态电流与温度的关系

典型特征

注意：本说明后面提供的图表是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 时连接至 $V_{\text{OUT}} = V_S/2$ ，除非另有说明。

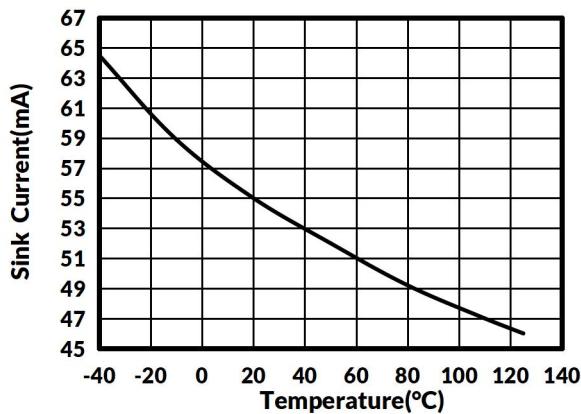


图 7. 灌电流与温度的关系

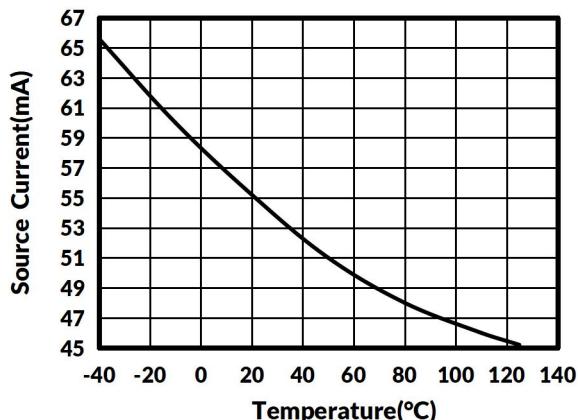


图 8. 源电流与温度的关系

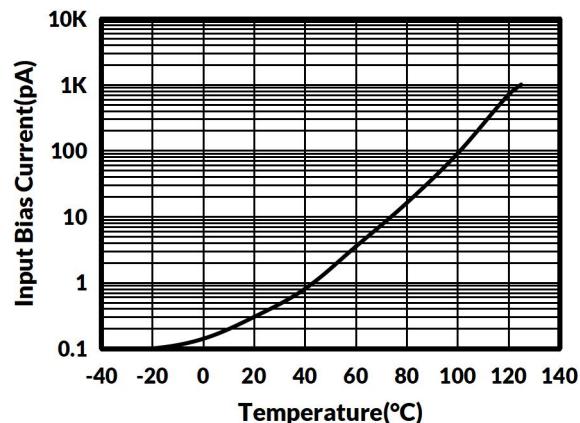


图 9. 输入偏置电流与温度的关系

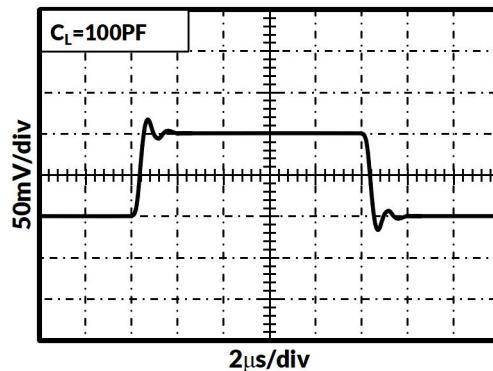


图 10. 小信号阶跃响应

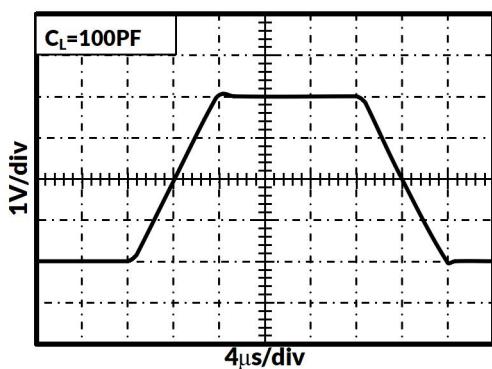


图 11. 大信号阶跃响应

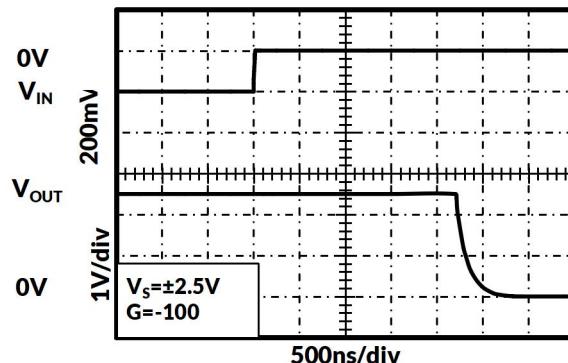


图 12. 正过压恢复

典型特征

注意：本说明后面提供的图表是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 、 $V_s = 5\text{V}$ 、 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 时连接至 $V_s/2$, $V_{\text{OUT}} = V_s/2$, 除非另有说明。

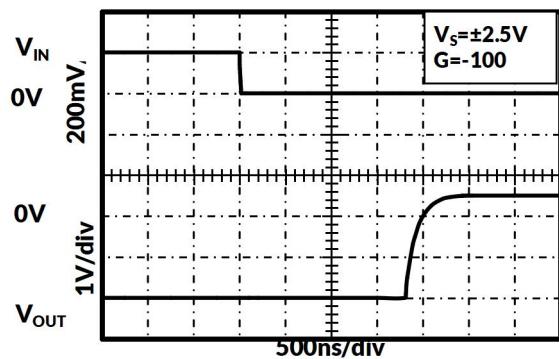


图 13. 负过压恢复

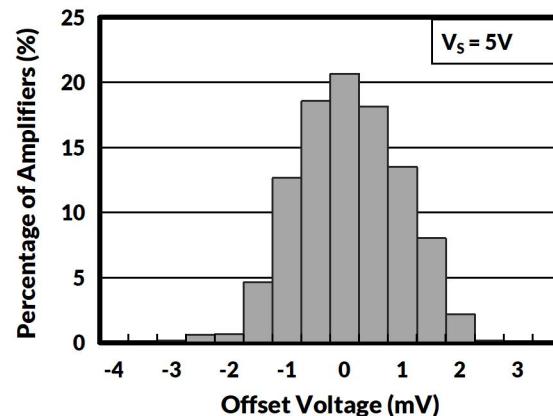


图 14. 失调电压产生分布

8 应用与实施

以下应用部分中的信息不属于 **TLXIC** 组件规范的一部分，**TLXIC** 不保证其准确性或完整性。**TLXIC** 的客户应自行负责确定组件是否适合其用途。客户应验证并测试其设计实现，以确认系统功能。

8.1 应用说明

TLX6331、**TLX6332**、**TLX6334** 均为高精度轨到轨运算放大器，可采用 **2.2V** 至 **5.5V** (**±1.1V** 至 **±2.75V**) 单电源供电。高于 **7V** (绝对最大值) 的电源电压可能会对放大器造成永久性损坏。轨到轨输入和输出摆幅会显著增加动态范围，尤其是在低电源应用中。良好的布局实践要求在电源引脚附近放置一个 **0.1 μF** 电容。

8.2 布局指南

始终建议遵循良好的布局实践。保持走线短。尽可能使用 **PCB** 接地层，并将表贴元件尽可能靠近器件引脚放置。在电源引脚附近放置一个 **0.1 μF** 电容。这些指导原则应贯穿整个模拟电路，以提高性能并提供诸如降低 **EMI** 敏感度等优势。

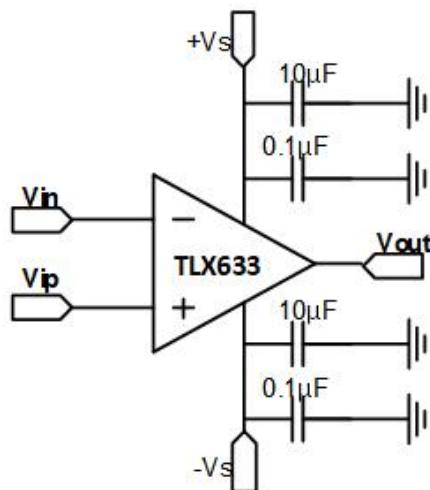


图 15. 带旁路电容的放大器

8.3 仪表放大器

在三运放中，仪表放大器的配置如图 16 所示。

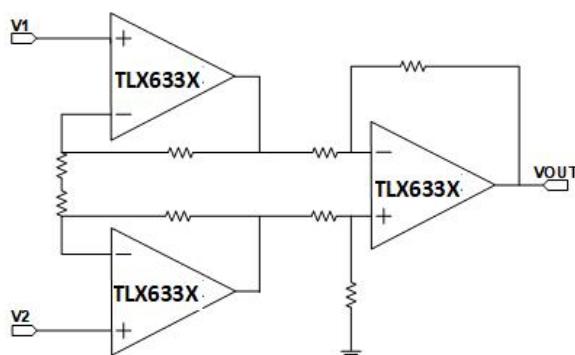
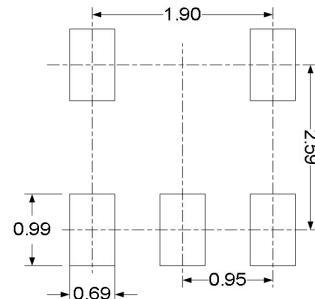
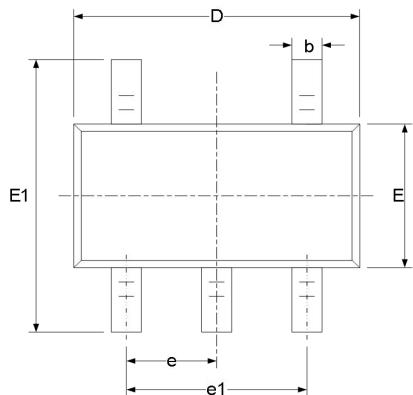


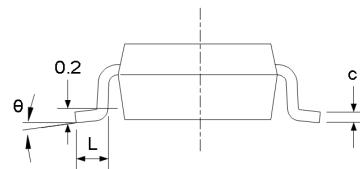
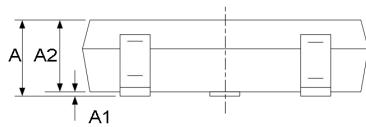
图 16. 放大器仪表放大器

9 封装外形尺寸

SOT23-5⁽³⁾



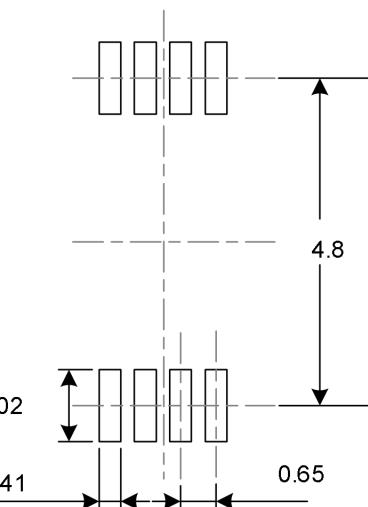
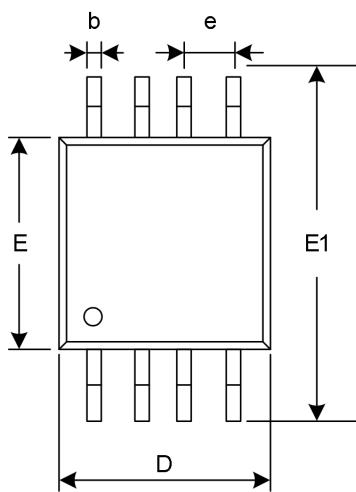
RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)



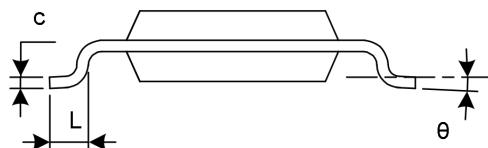
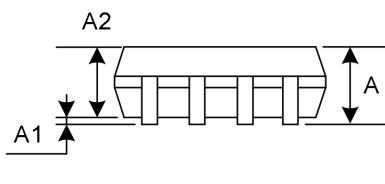
代码	尺寸(毫米)		尺寸(英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D ⁽¹⁾	2.820	3.020	0.111	0.119
E ⁽¹⁾	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC) ⁽²⁾		0.037(BSC) ⁽²⁾	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

笔记:

1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突出物。
- 2.BSC (中心间基本间距)，“基本”间距是标称的。
3. 本图纸如有更改，恕不另行通知。

MSOP8⁽³⁾

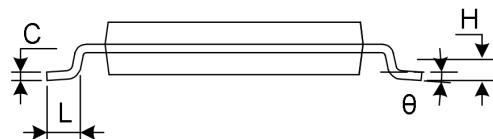
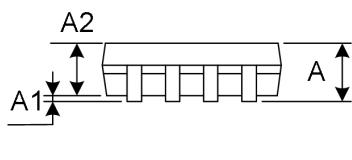
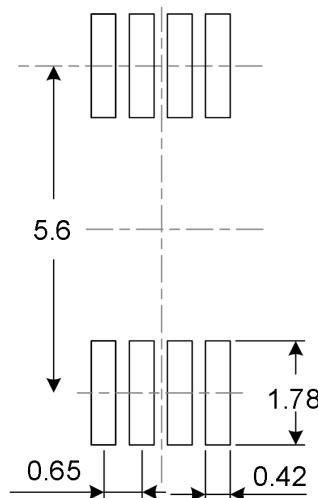
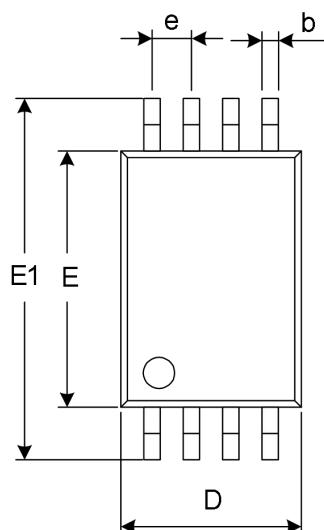
RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)



代码	尺寸(毫米)		尺寸(英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	0.820	1.100	0.032	0.043
A1	0.020	0.150	0.001	0.006
A2	0.750	0.950	0.030	0.037
b	0.250	0.380	0.010	0.015
c	0.090	0.230	0.004	0.009
D ⁽¹⁾	2.900	3.100	0.114	0.122
e	0.650(BSC) ⁽²⁾		0.026(BSC) ⁽²⁾	
E ⁽¹⁾	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	4.750	5.050	0.187	0.199
L	0.400	0.800	0.016	0.031
θ	0°	6°	0°	6°

笔记:

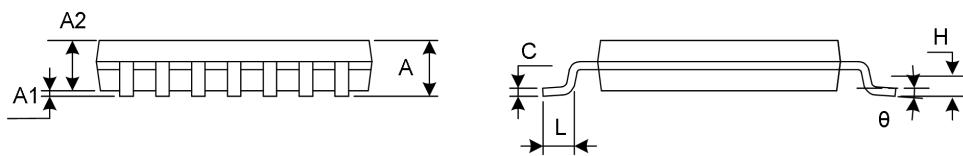
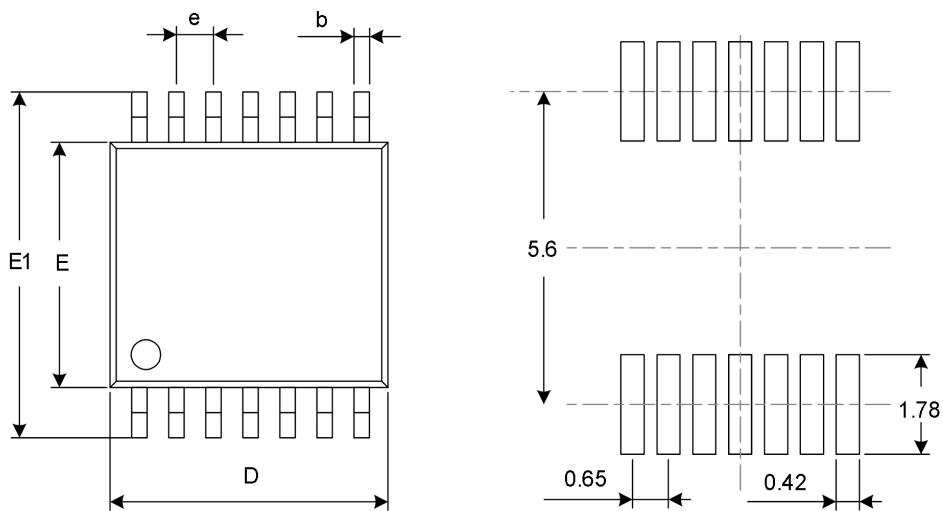
1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突出物。
- 2.BSC (中心间基本间距), “基本”间距是标称的。
3. 本图纸如有更改, 恕不另行通知。

TSSOP8⁽³⁾

代码	尺寸(毫米)		尺寸(英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾		1.200		0.047
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.800	1.050	0.031	0.041
b	0.190	0.300	0.007	0.012
c	0.090	0.200	0.004	0.008
D ⁽¹⁾	2.900	3.100	0.114	0.122
E ⁽¹⁾	4.300	4.500	0.169	0.177
E1	6.250	6.550	0.246	0.258
e	0.650(BSC) ⁽²⁾		0.026(BSC) ⁽²⁾	
L	0.500	0.700	0.020	0.028
H	0.250(TYP)		0.010(TYP)	
θ	1°	7°	1°	7°

笔记:

- 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突出物。
- BSC (中心间基本间距)，“基本”间距是标称的。
- 本图纸如有更改，恕不另行通知。

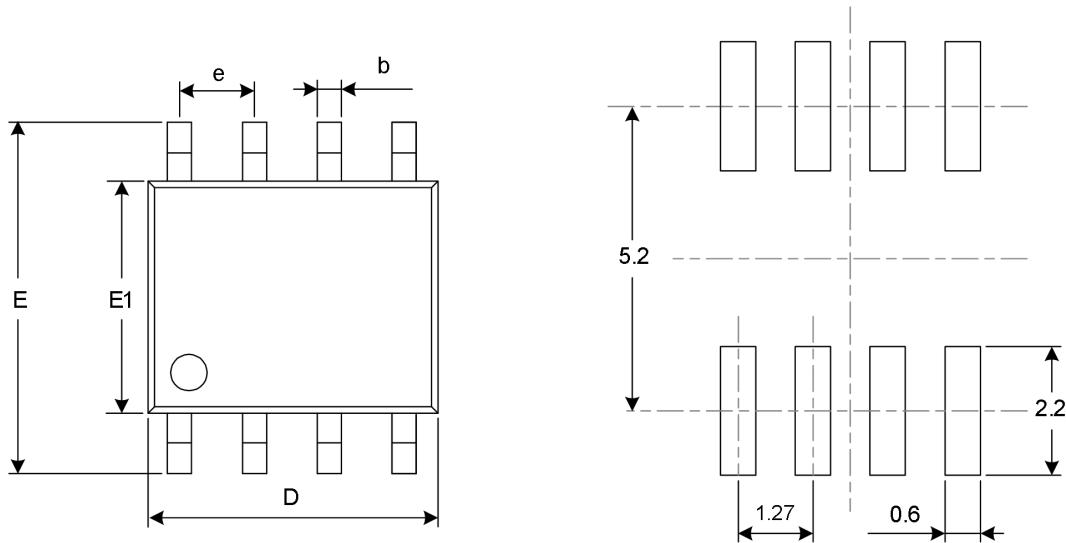
TSSOP14⁽³⁾

代码	尺寸(毫米)		尺寸(英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾		1.200		0.047
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.800	1.050	0.031	0.041
b	0.190	0.300	0.007	0.012
c	0.090	0.200	0.004	0.008
D ⁽¹⁾	4.860	5.100	0.191	0.201
E ⁽¹⁾	4.300	4.500	0.169	0.177
E1	6.250	6.550	0.246	0.258
e	0.650(BSC) ⁽²⁾		0.026(BSC) ⁽²⁾	
L	0.500	0.700	0.020	0.028
H	0.250(TYP)		0.010(TYP)	
θ	1°	7°	1°	7°

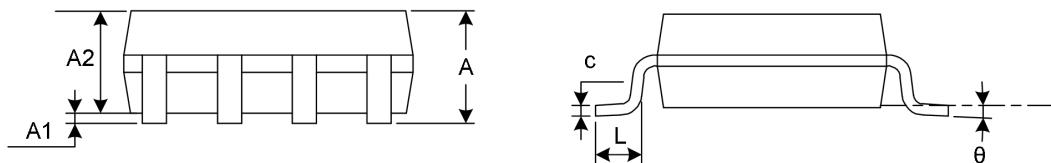
笔记:

1. 不包括每侧最大 **0.15** 毫米的塑料或金属突出物。
2. **BSC** (中心间基本间距)，“基本”间距是标称的。
3. 本图纸如有更改，恕不另行通知。

SOP8 (3)



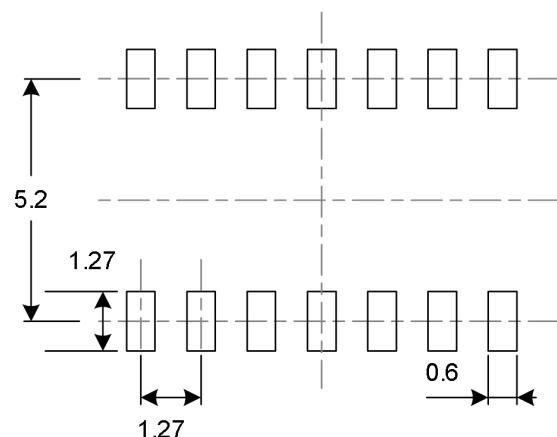
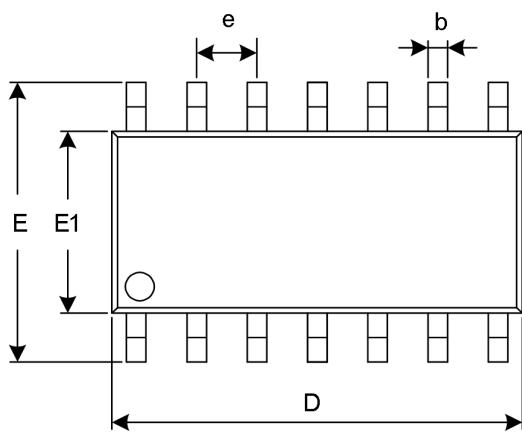
RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)



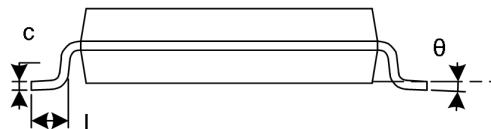
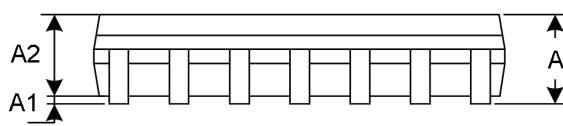
代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D ⁽¹⁾	4.800	5.000	0.189	0.197
e	1.270(BSC) ⁽²⁾		0.050(BSC) ⁽²⁾	
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1 ⁽¹⁾	3.800	4.000	0.150	0.157
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

笔记:

1. 不包括每侧最大 **0.15** 毫米的塑料或金属突出物。
2. **BSC** (中心间基本间距)，“基本”间距是标称的。
3. 本图纸如有更改，恕不另行通知。

SOP14⁽³⁾

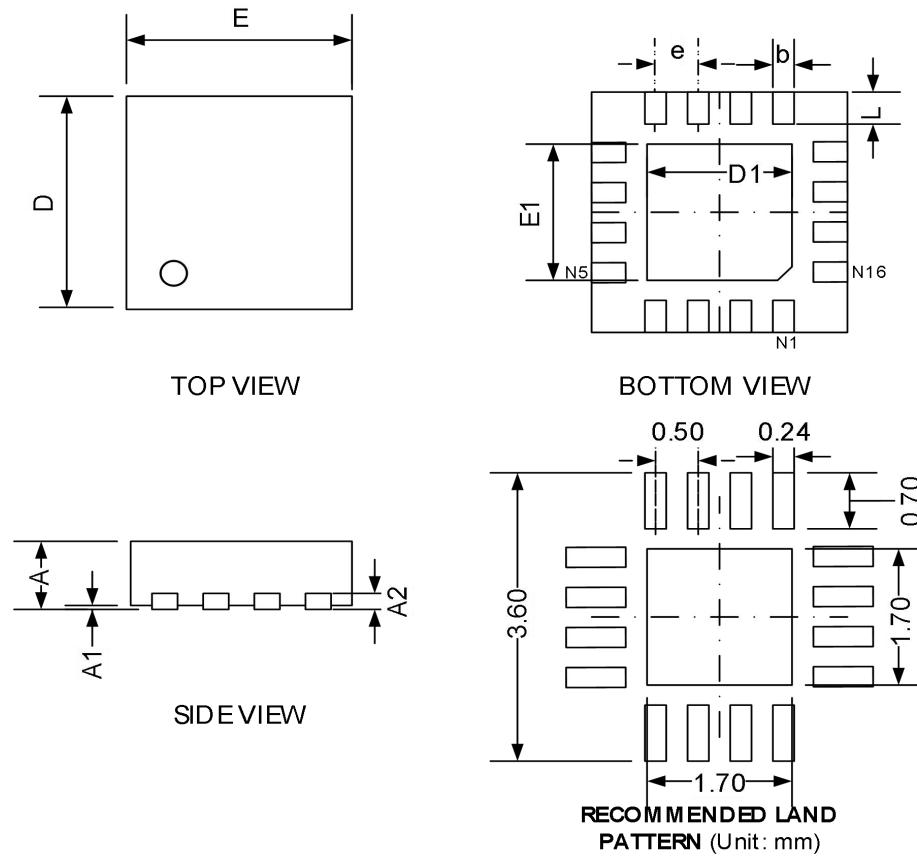
RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)



代码	尺寸(毫米)		尺寸(英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.310	0.510	0.012	0.020
c	0.100	0.250	0.004	0.010
D ⁽¹⁾	8.450	8.850	0.333	0.348
e	1.270(BSC) ⁽²⁾		0.050(BSC) ⁽²⁾	
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1 ⁽¹⁾	3.800	4.000	0.150	0.157
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

笔记:

1. 不包括每侧最大 **0.15** 毫米的塑料或金属突出物。
2. **BSC** (中心间基本间距)，“基本”间距是标称的。
3. 本图纸如有更改，恕不另行通知。

QFN 3X3-16⁽²⁾

代码	尺寸(毫米)		尺寸(英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	0.700	0.800	0.028	0.031
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A2	0.203		0.008	
b	0.180	0.300	0.007	0.012
D ⁽¹⁾	2.900	3.100	0.114	0.122
D1	1.600	1.800	0.063	0.071
E ⁽¹⁾	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	1.600	1.800	0.063	0.071
e	0.500 TYP		0.020 TYP	
L	0.300	0.500	0.012	0.020

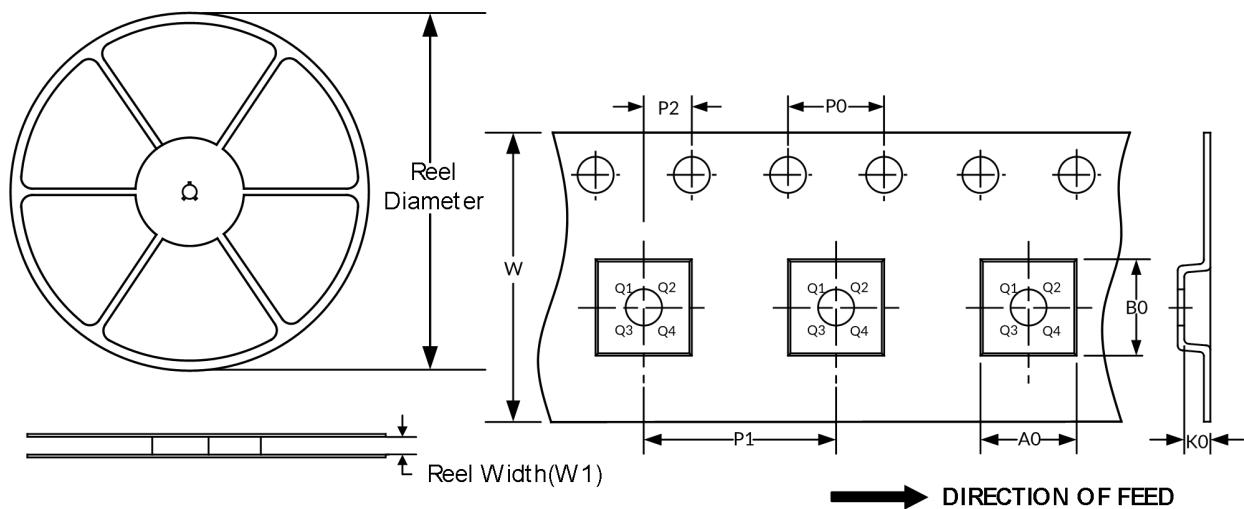
笔记:

1. 不包括每侧最大 **0.075** 毫米的塑料或金属突出物。
2. 本图纸如有更改，恕不另行通知。

10 卷带信息

卷轴尺寸

胶带尺寸



注：图片仅供参考，请以实物为准。

卷带封装关键参数表

封装类型	卷轴直径	卷筒宽度 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SOT23-5	7"	9.5	3.20	3.20	1.40	4.0	4.0	2.0	8.0	Q3
SOP8	13"	12.4	6.40	5.40	2.10	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1
MSOP8	13"	12.4	5.20	3.30	1.50	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1
SOP14	13"	16.4	6.60	9.30	2.10	4.0	8.0	2.0	16.0	Q1
TSSOP14	13"	12.4	6.95	5.60	1.20	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1
TSSOP8	13"	12.4	6.90	3.45	1.65	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1
QFN3X3-16	13"	12.4	3.35	3.35	1.13	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1

笔记：

1. 所有尺寸均为标称尺寸。
2. 不包括每侧最大 **0.15** 毫米的塑料或金属突出物。